

미래를 위한 동부

항상 벗어나 가길 바랍니다. 언제나 곁에서 지켜줄 것이라 믿었습니다.  
이미 그대는 가슴속에 스며 내가 되었음을 깨닫습니다.

대한민국 비메모리 반도체 산업의 미래를 이끄는 동부하이텍에서 첨단 핵심기술로 세계적인 부가가치를 창출할 젊은 아이디어를 공모합니다. 순수한 열정파, 독특한 아이디어파, 지독한 학구파... 누구라도 좋습니다. 독창적인 아이디어로 세상을 움직이고 싶은 젊은이라면 도전하세요!

동부 IP 설계공모전에서 당신의 꿈에 날개를 달아드립니다.

# 제6회 동부 IP 설계공모전

참가신청 2013.6.16(일)

참가대상 전국 대학교 대학(원)생 및 교수

공모내용

| 공정                                | 제작 칩 수 | 칩 크기                        | 패키지 지원      |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 0.11 $\mu$ m Mixed-Signal/RF CMOS | 20     | 2350 $\mu$ m x 2350 $\mu$ m | 80 Pin LQFP |
| 0.35 $\mu$ m High Voltage BCDMOS  | 20     | 2350 $\mu$ m x 2350 $\mu$ m | 80 Pin LQFP |

공모주제

| 구분    | IP 목록                                                      | 칩수 | 제작 공정                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 지정 과제 | 1. DSI(Display SerialInterface)IP                          | 4  | 0.11 $\mu$ m<br>Mixed-Signal/<br>RF CMOS |
|       | 2. CSI(Camera SerialInterface)IP                           | 4  |                                          |
|       | 3. USB 3.0 PHY IP                                          | 4  |                                          |
| 자유 과제 | 1. Analog IP for TSC (Touch Sensor Controller) Application | 4  | 0.35 $\mu$ m<br>High Voltage<br>BCDMOS   |
|       | 2. Analog IP for CMOS Power Amplifier                      | 4  |                                          |
| 지정 과제 | 1. DC-DC Converter for Mobile Application                  | 5  |                                          |
|       | 2. Charge Pump Regulator for LED Display                   | 5  |                                          |
|       | 3. Low Noise Amplifier for Audio Application               | 5  |                                          |
| 자유 과제 | 1. Low Power LDO (Low Drop Output) for Mobile Application  | 5  |                                          |

\* 현재 동일 IP 또는 아이디어로 타 기관 등에 출품되지 아니한 것  
\* DSI IP, CSI IP, USB 3.0 PHY IP의 상세 사양은 링크된 파일을 참조, 그 외 IP는 상세 사양 없음  
\* 칩 크기 : 2350 $\mu$ m x 2350 $\mu$ m (0.11 $\mu$ m, 0.35 $\mu$ m 공정)

일정

| 진행 내용                             | 0.11 $\mu$ m        | 0.35 $\mu$ m          |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 공모전 공고                            | 2013. 5. 13         |                       |
| 제안서 접수 마감                         | 2013. 6. 9          |                       |
| 제안서 평가 결과 발표                      | 2013. 6. 20         |                       |
| 공정 설계설명회 개최                       | 2013. 6. 24         |                       |
| 전반부(Front-End) 및 후반부(Back-End) 설계 | ~ 2013. 9. 10       | ~ 2013. 10. 22        |
| DB 접수(IDEC) 마감                    | 2013. 9. 11         | 2013. 10. 23          |
| DB검토                              | 2013. 9. 11 ~ 9. 30 | 2013. 10. 23 ~ 11. 04 |
| DB 전달                             | 2013. 10. 01        | 2013. 11. 05          |
| Mask & Fab                        | ~ 2014. 01. 21      | ~ 2014. 02. 04        |
| 패키지 작업                            | 2014. 1. 22 ~ 2. 22 | 2014. 2. 05 ~ 3. 05   |
| 칩 테스트(설계자 자체 실시)                  | ~ 2014. 3. 30       | ~ 2014. 3. 30         |
| 논문 접수 마감                          |                     | 2014. 4. 13           |
| 발표평가 및 시상식                        |                     | 2014. 4월 말            |

시상

| 시 상 | 시상 내역           | 시상팀 수 |
|-----|-----------------|-------|
| 대상  | 상장, 상금(1,000만원) | 1     |
| 금상  | 상장, 상금(500만원)   | 1     |
| 은상  | 상장, 상금(300만원)   | 1     |
| 동상  | 상장, 상금(200만원)   | 2     |

\* 산·학 공동개발의 우선 체결 및 협력 전개  
\* 본선 입상자가 (주)동부하이텍에 취업을 희망하는 경우 가산점 부여함

기타세부내용

(주)동부하이텍 홈페이지 <http://www.dongbuhitek.co.kr>  
IDEC 홈페이지 <http://www.idec.or.kr>

문의처

IDEC 조인신 (ischo@idec.or.kr)  
IDEC 김은주 (ejkim@idec.or.kr, 042-350-8533)

주관  Dongbu HiTek  반도체설계교육센터  
IC DESIGN EDUCATION CENTER

후원  동부문화재단